

## PRESSEMITTEILUNG

Zwolle – 12. Dezember 2016

### RoodMicrotec gewinnt neue Verträge über 5 Millionen Euro

**RoodMicrotec**, der niederländische Halbleiterlieferant von hochentwickelten Mikrochips, hat sich zwei signifikante neue Verträge gesichert, von denen erwartet wird, dass der Auftragsbestand um mindestens um weitere 5 Millionen Euro – verteilt über die nächsten 10 Jahre – anwachsen wird. Die Firma erwartet einen Auftrag von 4,5 Millionen Euro seitens eines Kunden, der im Industriesektor und im Automobilbereich tätig ist und erwartet eine Förderung von 850.000 Euro seitens der EU und einer deutschen Förderung für ein gemeinsames Technologieprojekt bis zum Jahr 2019.

Der neue Supply Chain Management-Vertrag (SCM) zwischen **RoodMicrotec** und einem deutschen Kunden aus dem Industrie- und Automobilbereich wird Anfang 2017 mit einem ersten Auftrag über 100.000 Euro starten, der zum Ende des Jahres abgeschlossen sein wird. Aus den Folgeaufträgen wird ein zusätzlicher Umsatz von mindestens 4,4 Millionen Euro über 10 Jahre erwartet.

**Reinhard Pusch, RoodMicrotec COO**, sagte: *“Da die Anwendung, die wir für diesen deutschen SCM-Auftrag entwickeln, auch mit anderen Systemen und Designs genutzt wird, erwarten wir, dass es zu einem organischen Wachstum des Unternehmensumsatzes führt.”*

Darüber hinaus erhielt **RoodMicrotec** für die nächsten drei Jahren öffentliche Zuschüsse in Höhe von 850.000 Euro, die von ECSEL Joint Undertaking, einer öffentlich-privaten Partnerschaft für die Entwicklung der europäischen elektronischen Komponenten- und Systemindustrie, genehmigt wurden. Die Organisation hat insgesamt 7,2 Mio. EUR an EU-Mitteln für das Projekt EuroPAT-MASIP vergeben, für das **RoodMicrotec** einer der 27 Partner ist. Das vorgeschlagene Projekt soll einen bedeutenden Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit Europas und zur Schaffung von Arbeitsplätzen in der Elektronikindustrie leisten.

**Bert De Colvenaer, Geschäftsführer bei ECSEL JU**, sagte: *“Diese Projekte repräsentieren die Spitze der industriellen und akademischen Spitzenleistungen in Europa auf unserem Gebiet. Wir sind davon überzeugt, dass diese Entscheidung ein weiterer Meilenstein für Europa ist, wenn es darum geht, unsere gemeinsamen Ziele im Bereich der elektronischen Komponenten und Systeme zu erreichen.”*

Das geförderte Projekt umfasst die Entwicklung von ASICs (Application Specific Integrated Circuits) für ein MEMS-Gyroskop, für einen Bildsensor und für ein Radio Frequency (RF) ASIC. Durch die Teilnahme am Projekt kann RoodMicrotec sein bestehendes Know-how in allen drei Bereichen verfeinern.

**Reinhard Pusch, RoodMicrotec COO** schließt: *“Diese beiden Projekte ermöglichen es RoodMicrotec, die Entwicklung seiner ASIC Supply Chain Management-Kompetenz auf ein neues Niveau zu bringen. Die öffentliche Anerkennung, dass das Unternehmen einen wertvollen Beitrag zum Wachstum und zur Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Elektronikindustrie leistet, ist auch eine starke Bestätigung für die Qualität der Dienstleistungen, die wir dem Markt anbieten.“*

**ENDE**

#### **Über ECSEL JU:**

ECSEL JU (Electronic Components and Systems European Leadership Joint Undertaking) ist eine Partnerschaft von privaten und öffentlichen Bereichen für elektronische Komponenten und Systeme.

Elektronische Komponenten und Systeme (ECS) sind eine weit verbreitete Schlüsseltechnologie, die alle Industriezweige und fast alle Aspekte des Lebens beeinflusst. Ein Smartphone, eine Smartcard, ein intelligentes Energienetz, eine intelligente Stadt, sogar intelligente Steuerung; Alles "smart" basiert auf der Integration von Halbleiterchips mit eingebetteter Software. Sie bieten den Stoff, auf dem das Internet basiert; sie geben Mobiltelefonen und Tablets ihre Funktionen; sie fahren fahrerlose Autos und Züge, fliegen Flugzeuge, Drohnen und Satelliten. In der modernen Zeit kann keine Volkswirtschaft im globalen Wettbewerb gewinnen, ohne diese Technologie zu meistern, mit unvergleichlichen systemischen und strategischen Auswirkungen.

#### **Über EuroPAT-MASIP:**

EuroPAT-MASIP (European Packaging Assembly and Test pilot for Manufacturing of Advanced System in Package) ist ein Projekt, das an die ECSEL JU für Europäische Förderung eingereicht wurde. Partner des eingereichten Projektes sind:

3DiS Technologies, Advanced Vacuum Distribution Europe AB, Afore Oy, AMIC Angewandte Micro Messtechnik GmbH, Berliner Nanotest und Design GmbH, BESI Austria GmbH, BESI Netherlands BV, Commissariat al Energie Atomique et aux Energies Alternatives, Connaught Electronics Limited, ELMOS Semiconductor AG, EV Group E. Thallner GmbH, Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., INNOSENT GmbH, KETEK, micro analog systems Oy, MURATA Electronics Oy, Nanium S.A., Nokian Tyres plc., NXP Semiconductors France SAS, PAC TECH Packaging Technologies GmbH, Packaging SIP, RoodMicrotec GmbH, Semilab Felvezeto Fizikal Laboratorium Reszvenytarsasag, SENCIO BV, Silicon Radar GmbH, Spinverse Innovation Management Oy, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, TexEDA Design GmbH

## Über RoodMicrotec

Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung als unabhängiger Value-Added-Dienstleister für die Mikro- und Optoelektronik, bietet RoodMicrotec ein "Alles aus einer Hand"-Angebot für Fabless-Firmen, OEMs und anderen Geschäftspartnern an. RoodMicrotec hat sich mit seinen *powerful solutions* eine starke Position in Europa aufgebaut.

Unsere Dienstleistungen erfüllen die höchsten Industrie- und Qualitätsanforderungen, wie sie in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Automobil, Telekommunikation, Medizin, IT und Elektronik gefordert werden.

'Certified by RoodMicrotec' bedeutet Prüfen von Produkten unter anderem gemäß dem strengen ISO/TS 16949-Standard für Zulieferer der Automobilindustrie. Die Firma besitzt akkreditierte Labors für Test und Qualifikation gemäß der Norm ISO/IEC 17025.

Die Value-Added Dienstleistungen umfassen (eXtended) Supply Chain Management, Fehler- & Technologieanalysen, Qualifikationen und messenden Burn-In, Test- & Produkt-Engineering, Produktionstest (einschließlich Bauelementeprogrammierung und End-of-Line-Dienstleistungen), ESD/ESDFOS Evaluation & Training, Qualitäts- und Zuverlässigkeits-Beratung und den kompletten Herstellprozess mit Partnern.

RoodMicrotec besitzt Niederlassungen in Deutschland (Dresden, Nördlingen, Stuttgart), in Großbritannien (Bath) und in den Niederlanden (Zwolle).

Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Webseite <http://www.roodmicrotec.com>

## Weitere Informationen

Martin Sallenhag CEO; Reinhard Pusch COO; Vic Tee Vorsitzender des Aufsichtsrates;  
Arvid Ladega CFO.

Telephone: +31 38 4215216

Postal address:

RoodMicrotec N.V., PO Box 1042, 8001 BA Zwolle

Email: [investor-relations@roodmicrotec.com](mailto:investor-relations@roodmicrotec.com) Web: [www.roodmicrotec.com](http://www.roodmicrotec.com)

*Diese Pressemitteilung wird in Englisch, Niederländisch und Deutsch publiziert. Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die Englische Fassung Gültigkeit.*